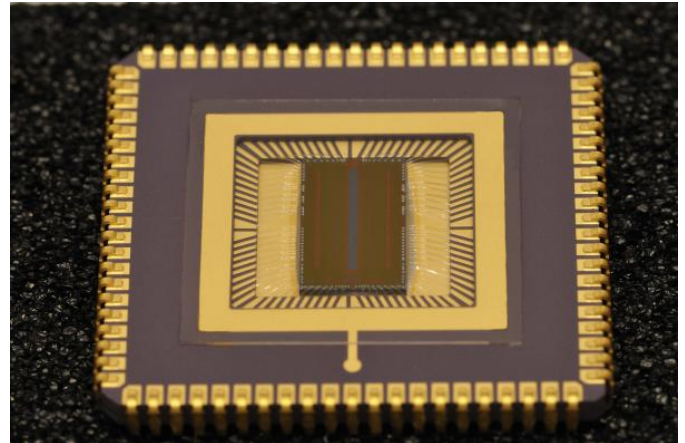




יש חברות המעורבות בשוק האלקטרוניקה הרגיש, היודעות כי זהו שוק של עליות וירידות מחזוריות אך יחד עם זאת שוק מאתגר ומלא הזדמנויות. חברות אלה יכולות לנצל את האתגר שבתקופתנו ולהפוך אותו להזדמנות ע"י:

- ישום מערכת לניהול מלאי שמטרתה הורדת עליות יצור ומחירים
- פיתוח חוזים חדשים לשם שימור נאמנות לקוחות והתגברות על מתחרים
- שינוי אסטרטגיית מחירים וחוזים עם חברות יצור שבבים ושותפים
- הרחבת שט"פים בנושא IP
- סגירה או מכירה של פאבים ישנים במקום לשדרג אותם
- שדרוג פאבים לטכנולוגיות חדשות כמו אנרגיה סולארית MEMS
- פיתוח מדיניות מחירים וקווי מוצרים רב שלביים
- מיקוד מחדש של אסטרטגיות השיווק על לקוחות חדשים ומוצרים חדשים
- רכישת חברות במטרה לרכוש טכנולוגיות ונסיון הנדסי
- התאמת כלים ומוצרים ליכולות היצור של הפאבים.

ב-2006 נתן האנליסט גרי סמית מספר המלצות בנוגע להזדמנויות גידול עתידי לחברות EDA ולמתכנני שבבים:

- הגדלת פיתוח לתכנונים בטכנולוגיות 65 ו-45 ננו.
- בפונקצינאליות אקספוננציאלית לגידול דוחפות תחרות ואסטרטגיות RF מעגלי צרכי - SIP vs. SOC שחייבת להיות משולבת לתוך אותו גודל ואותו מחיר
- פתרונות package-on-Package (PoP) and package die-to-die
- אתגרי תכנון PCB ואריזות חדשות בישומי הדור הרביעי (4G) של תקשורת אלחוטית חייבות להיות תואמות לאחור גם לדורות 2G/3G
- תשתית תכנון ומודלים הדרושים ליצור יעיל של שבבים. ישומים כגון אלה מתוארים בתרשים 1 והם אשר איפשרו להרחיב את גבולות התכנון של אריזות קיימות, לוחות, יכולת תכנון מערכות וכלי EDA.

גרף

מקור: 2009 April EDA Smith Gary & Cadence

כיום, מספר רב של חברות EDA מציעות מגוון של פלטפורמות אשר פותחו במשותף או חלקי תוכנה חדשה בכדי לגשר על פערים בתכנון מסיליקון ועד לאריזה, מלוח ועד מערכת. הפלטפורמות שלהם דורשות יותר שתפ"ם עם יצרני סיליקון ואריזות וכן עם יצרני המייצרים מלוח ועד רמת המערכת. פרספקטיבה זו תכסה מספר נבחר של חברות שלאחרונה הציגו מוצרים ומתחרות בפלטפורמות המבוססות על פיתוח משותף עבור ה end-Front (וה- end-back של התכנון) גם יחד.

מספר ספקי EDA מעריכים את הפאבים ואת ספקי ה SATS לביצוע אופטימיזציה של ה interconnect לאורך כל ה domain board-package-chip דרך פתרונות תכנון משותפים. ע"י לקיחת עמדה אגרסיבית בתכנון משותף הם בונים מערכת יחסים עם לקוחות ורואים בכך דרך להתמודד עם מתחרים. שתי חברות Apache Design הן מתקדמות משותפות תכנון פלטפורמות בהצגת מאד המעורבות ספציפיות EDA גרפיקס מנטור עם עובדות או פעולה משתפות החברות שתי Agilent של EDA -ה וחטיבת Solutions וקיידנס - שני ספקים ענקיים של פתרונות design-co System-Board-Package . חברת Apache –סטאראט אפ שהוקם בשנת 2001 רכשה את חברת Optimal ב-2007. בסיס הטכנולוגיה של Optimal כולל פתרונות 3D, signal, power, and thermal analysis עבור EDA עם ה שוק את מובילה היא כי טוענת Apache היום. Package-Board-System co-design solutions. מיקוד של 100% על package the to IC from solutions design-co analysis noise and power שלה Sentinel ה מוצר באמצעות domain קוו מוצרים זה מיועד לתכנוני 54 ננו ומטה עם דגש מיוחד על TSVs and 3D (Vias Silicon Through).

ADS 2009 HF/High speed שלה המשותף התכנון פלטפורמת את הציגה אגילנט – Agilent's EEsof front end (simulation and verification) ב-2009. front end שלה ה front end (simulation and verification) ב-2009. ADS 2009 co-design היא ה של הרכה הנקודה. וסינופסיס קיידנס עבור המשותף התכנון של back-end' החוזק שלו בתחום ה RF. כפי שצוין ע"י אגילנט, השכבה הפיזית של ה RF של כל מערכת אלחוטית דורשת אינטגרציה מוצלחת של ריבוי טכנולוגיות כדי לעמוד בדרישות הנתונים של תקשורת אלחוטית כדוגמת LTE, WiMax, WiMedia, HD Wireless, וכדומה.

כפי שצוין ע"י כל ארבעת החברות, תכנון משותף של מעגל משולב (IC) module/package או ממשק PCB [ברגע שהם הופכים לזמינים כחלק SHELF THE OFF או [designs Simulated] מקטין את הסיכון לכישלון או דחייה בלוח הזמנים. אם הספק יוכל לתעל את הורדת הסיכון לתוך מערכת אלחוטית או מערכת תקשורת מהירה, ההחזר על ההשקעה יכול להיות מאד משמעותי מאחר והוא מקצר את זמן התכנון ואת מחיר העבודה.

מרי אן אולסן. - מרי אן אולסן היא אנליסטית מרכזית בחברת המחקר EDA Smith Gary. בעבר שימשה כסמנכ"ל מחקר בגרטנר דטקווסט.

{loadposition content-related}